

國立交通大學  
材料科學與工程學系  
博士論文

三五族化合物半導體晶圓接合之基本研究及應用

Fundamental Studies and Applications of III-V Compound

Semiconductor Wafer Bonding



研究生：劉柏均

指導教授：吳耀銓 博士

中華民國九十四年七月

三五族化合物半導體晶圓接合之基本研究及應用  
Fundamental Studies and Applications of III-V Compound  
Semiconductor Wafer Bonding

研究生：劉柏均

Student : Po-Chun Liu

指導教授：吳耀銓

Advisor : YewChung Sermon Wu Ph.D.

國立交通大學  
材料科學與工程學系  
博士論文



Submitted to Department of Material Science and Engineering  
College of Engineering

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Doctor of Philosophy

in

Material Science and Engineering

July 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年七月